

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 6 月 5 日 (05.06.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/046078 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08L 67/02, B42D 15/10, C08L 77/06, C09J 167/02, 177/06, G06K 19/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/12315

(22) 国際出願日: 2002 年 11 月 26 日 (26.11.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2001-365418
2001 年 11 月 30 日 (30.11.2001) JP

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 今堀 誠 (IMA-HORI, Makoto) [JP/JP]; 〒455-0027 愛知県 名古屋市 港区船見町 1 番地の 1 東亜合成株式会社 名古屋総合研究所内 Aichi (JP). 高橋 伸 (TAKAHASHI, Shin) [JP/JP]; 〒455-0027 愛知県 名古屋市 港区船見町 1 番地の 1 東亜合成株式会社 名古屋総合研究所内 Aichi (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, DE, GB, JP, KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

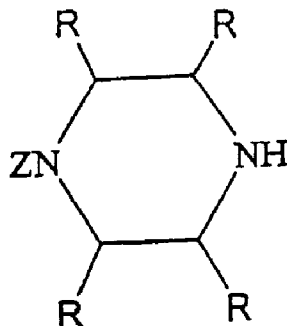
添付公開書類:
— 国際調査報告書

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東亜合成株式会社 (TOAGOSEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒105-8419 東京都 港区 西新橋一丁目 1 4 番 1 号 Tokyo (JP).

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION FOR IC CARDS

(54) 発明の名称: IC カード用熱可塑性樹脂組成物



(1)

(57) Abstract: An IC card constituted of an IC substrate, a hot-melt resin layer and a skin in which the three are so strongly bonded with each another as to cause little delamination and which permits embossing. A resin composition comprising the following specific polyester and polyamide is used as the hot-melt resin. Polyester: a saturated copolyester comprising polyol units derived from cyclohexanedimethanol, and Polyamide: a copolyamide comprising polyamine units derived from a compound of the general formula (1): (1) wherein four Rs may be the same or different from each other and are each hydrogen or C₁₋₄ alkyl; and Z is hydrogen or NH₂R' (wherein R' is C₁₋₄ alkylene).



WO 03/046078 A1

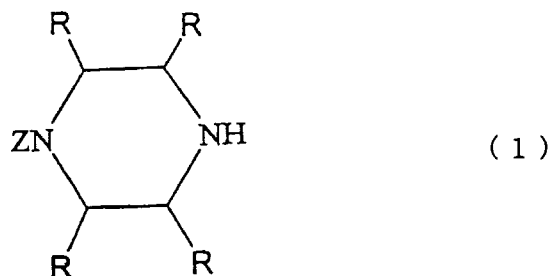


(57) 要約:

I C基板、ホットメルト樹脂層および表皮材からなるI Cカードであって、それらの3者が強固に接合しており、剥がれが生じにくく、しかも高いエンボス加工が可能なI Cカード。ホットメルト樹脂として、以下の特定のポリエステルおよびポリアミドからなる樹脂組成物を採用することにより、課題を解決した。

ポリエステル；ポリオール単位としてシクロヘキサンジメタノール単位を有する飽和共重合ポリエステル

ポリアミド；ポリアミン単位として下記一般式（1）で表される化合物に基づく単位を有する共重合ポリアミド



（上式において、Rは、水素原子又は炭素数1～4のアルキル基であり、4個のRは互いに同じであっても異なっても良い。またZは、水素原子又は基NH₂ R'であり、R'は炭素数1～4のアルキレン基である。）